

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2024-021

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日